

RM1233AM 数据手册

单键触摸检测 IC

V 1.7 2023-02-15



深圳锐盟半导体有限公司

Realmagic Semiconductors (Shenzhen) Co.,Ltd.

深圳市南山区高新北四道 13 号宇阳大厦 3 层 www.realmagicsemi.com





目 录

3 3 4
4
4
6
6
7
7
11
12
12
12
12
13
13
13
14
21
21
22
23
24
25



1 产品简介

1.1 概述

RM1233AM 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。

1.2 主要特性

- 工作电压 2.3V~5.5V
- 内建稳压电路提供稳定的电压给检测电路使用
- 内建低压重置(LVR)功能
- 快速模式待机电流3.3uA@VDD=3V, 无负载
- 可触摸检测输入脚接外部电容(0~20pF)调整灵敏度
- 输出模式已配置完成,包括高低电平有效输出、同步/保持模式、最大开启时间,省掉外部选择电阻
- 上电后约有0.5秒的稳定时间
- 自动校准功能、环境自适应校准功能
- 刚上电8秒内约1秒刷新一次参考值,若上电后的8秒内有触摸键或8秒后仍未触摸按键,则重新校准周期为4秒
- DFN1X1-4L、DFN-6L、SOT23-6L封装

1.3 应用范围

- 各种消费性产品
- 取代按钮按键



2 选型表/订购信息

选型一览表

		输出信息		触	控时间参	数	
主型号	模式	状态	结构	最长 响应	最长 输出	复位	封装
RM1233AM-KGSA	同步	低有效	开漏	60ms	16s	16s	SOT23-6L
RM1233AM-KGHA	保持	低有效	开漏	60ms		16s	SOT23-6L
RM1233AM-CGSB	同步	高有效	CMOS	60ms	16s	16s	SOT23-6L
RM1233AM-CGHB	保持	高有效	CMOS	60ms		16s	SOT23-6L
RM1233AM-CGSC	同步	可配置	CMOS	60ms	16s	16s	SOT23-6L
RM1233AM-CGSD	同步	可配置	CMOS	60ms	16s	16s	SOT23-6L
RM1233AM-KDSA	同步	低有效	开漏	60ms	16s	16s	DFN-6L
RM1233AM-KDHA	保持	低有效	开漏	60ms		16s	DFN-6L
RM1233AM-CDSA	同步	低有效	CMOS	60ms	16s	16s	DFN-6L
RM1233AM-CDHA	保持	低有效	CMOS	60ms		16s	DFN-6L
RM1233AM-CDSB	同步	高有效	CMOS	60ms	16s	16s	DFN-6L
RM1233AM-CDSC	同步	可配置	CMOS	60ms	16s	16s	DFN-6L
RM1233AM-CDSD	同步	可配置	CMOS	60ms	16s	16s	DFN-6L
RM1233AM-CDHB	保持	高有效	CMOS	60ms		16s	DFN-6L
RM1233AM-KD1SA	同步	低有效	开漏	60ms	16s	16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-KD1HA	保持	低有效	开漏	60ms		16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-CD1SA	同步	低有效	CMOS	60ms	16s	16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-CD1HA	保持	低有效	CMOS	60ms		16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-CD1SB	同步	高有效	CMOS	60ms	16s	16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-CD1HB	保持	高有效	CMOS	60ms		16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-CD1SC	同步	高有效	CMOS	60ms	16s	16s	DFN1X1-4L
RM1233AM-CD1SD	同步	高有效	CMOS	60ms	∞	8	DFN1X1-4L



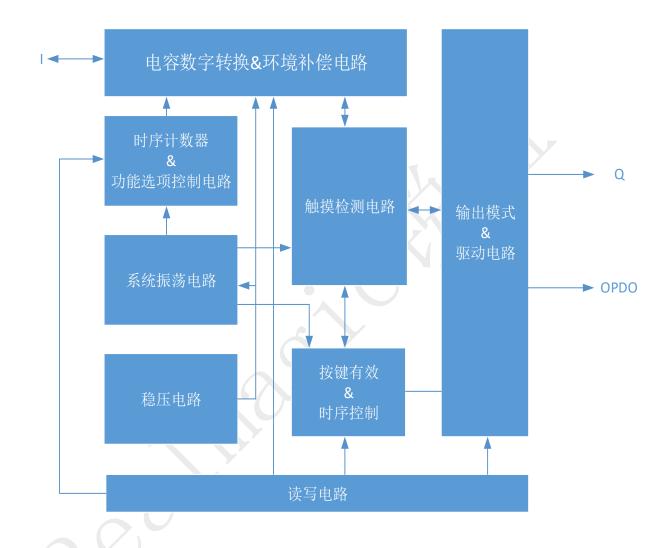
订购信息一览表

产品型号	封装	包装类型	包装数量
RM1233AM-KGSA	SOT23-6L	编带	3000
RM1233AM-KGHA	SOT23-6L	编带	3000
RM1233AM-CGSB	SOT23-6L	编带	3000
RM1233AM-CGHB	SOT23-6L	编带	3000
RM1233AM-CGSC	SOT23-6L	编带	3000
RM1233AM-CGSD	SOT23-6L	编带	3000
RM1233AM-KDSA	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-KDHA	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-CDSA	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-CDHA	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-CDSB	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-CDSC	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-CDSD	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-CDHB	DFN-6L	编带	5000
RM1233AM-KD1SA	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-KD1HA	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-CD1SA	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-CD1HA	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-CD1SB	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-CD1HB	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-CD1SC	DFN1X1-4L	编带	5000
RM1233AM-CD1SD	DFN1X1-4L	编带	5000



3 芯片功能

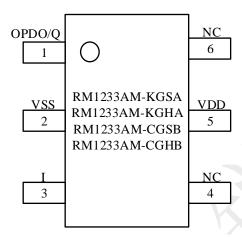
3.1 芯片框图





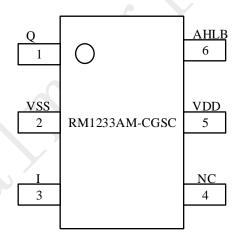
3.2 管脚配置

3.2.1 管脚排列图



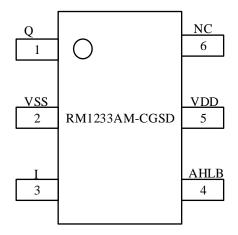
RM1233AM-KGSA/ KGHA/CGSB/CGHB

SOT23-6L

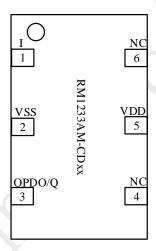


RM1233AM-CGSC SOT23-6L



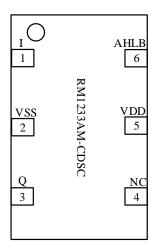


RM1233AM-CGSD SOT23-6L

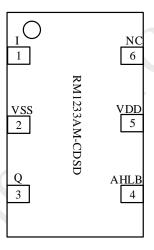


RM1233AM-CDSA/CDSB/CDHA/CDHB/KDSA/KDHA DFN-6L



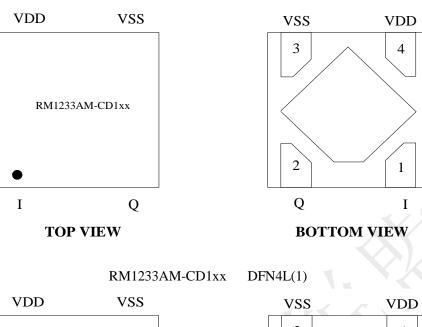


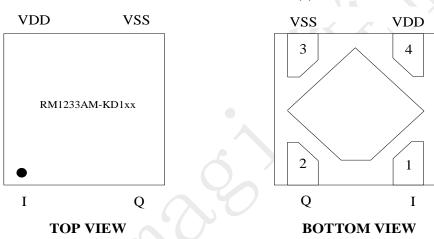
RM1233AM-CDSC DFN-6L



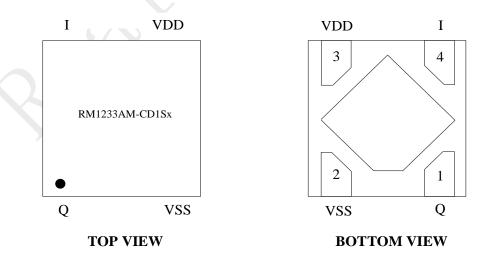
RM1233AM-CDSD DFN-6L







RM1233AM-KD1SA/KD1HA DFN4L(1)



RM1233AM-CD1SC/CD1SD DFN4L(2)



3.2.2 脚位定义

SOT23-6L 脚位顺序	DFN-6L 脚位顺序	DFN4L(1) 脚位顺序	DFN4L(2) 脚位顺序	脚位名称	I/O 类型	脚位定义
3	1	1	4	I	I	传感器输入
2	2	3	2	VSS	P	负电源供应
1	3	2	1	Q	О	CMOS 输出
1	3	2		OPDO	OD	N 管开漏输出脚, 低电平有效
4	4	/	/	/AHLB	/I-P _L	浮空/输出高/低电 平配置位
5	5	4	3	VDD	P	正电源供应
6	6	/	/	/AHLB	/I-P _L	浮空/输出高/低电 平配置位
				/TOG	/I-PL	同步/保持模式选择

接脚类型

• I CMOS 单纯输入

• Q CMOS 输出

• P 电源/地

· OD 开漏输出

• I-PL/ I-PH 带内部下拉/上拉电阻的 CMOS 输入



4 功能描述

4.1 灵敏度调整

RM1233AM 提供一些外部调整灵敏度的方法:

1. 调整检测板尺寸的大小

在其它条件不变的情况下,使用较大的检测板尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但电极尺寸必须在有效范围内使用。

2. 调整介质(面板)厚度

在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但 介质厚度必须在最大限制值以下。

3. 调整 Cs 的大小

在其它条件不变的情况下,若未在触摸 PAD 上对 VSS 接上 Cs 电容时,灵敏度最高,若 Cs 的电容在可用范围内($0\sim20 pF$),Cs 电容值越大,灵敏度越低。

4.2 输出模式

RM1233AM 根据产品选型表,输出同步或保持模式,CMOS 或开漏输出,高或低电平有效。

模式设置引脚	功能		默认状态
快入仪重灯脚	设置为高(1) 设置为低(0)		
AHLB	引脚输出低有效	引脚输出高有效	0
TOG	保持模式输出	同步模式输出	0

4.3 抗干扰能力

RM1233AM 具有很强的抗干扰能力,可以用在干扰比较大的地方。客户如果需要更高抗干扰能力,请与锐盟 FAE 沟通。



5 电气特性

5.1 最大绝对额定值

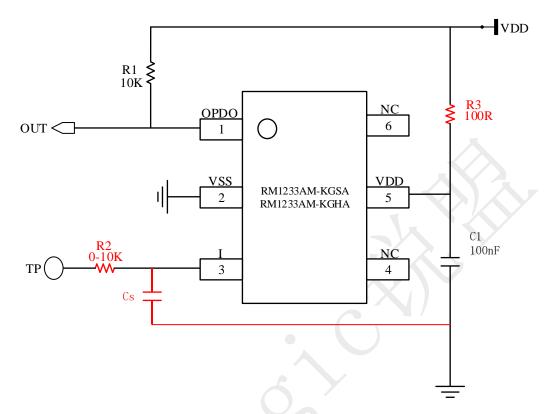
参数	符号	条件	值	单位
工作温度	T_{OP}	1	-40∼+85	$^{\circ}\mathrm{C}$
储存温度	T_{STG}	_	-50∼+125	°C
电源供应电压	VDD	Ta=25°C	VSS-0.3~VSS+5.5	V
输入电压	V_{IN}	Ta=25°C	VSS-0.3~VDD+0.3	V

5.2 **DC/AC** 特性(测试条件室温=**25**℃)

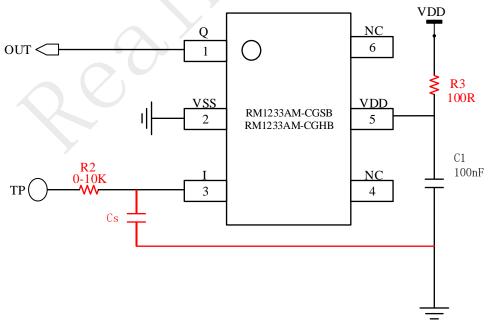
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VDD		2.3	3	5.5	V
内部稳压电路输出	VREG		2.2	2.3	2.4	V
静态电流	I_{DD}	VDD=3V 快速模式		3.3		uA
输入脚	$V_{\rm IL}$	输入低电压	0		0.2	VDD
输入脚	V_{IH}	输入高电压	0.8		1.0	VDD
输出脚灌电流	I_{OL}	VDD=3V, V _{OL} =0.6V		8		mA
Sink Current	IOL	VDD=3 V, V _{OL} =0.0 V		0		IIIA
输出脚源电流	Ι	VDD=3V, V _{OH} =2.4V		-4		mA
Source Current	Іон	ν DD=3 v, V OH=2.4 V		-4		шА
输出响应时间	T_R	VDD=3V,快速模式		60		mS



6 应用电路

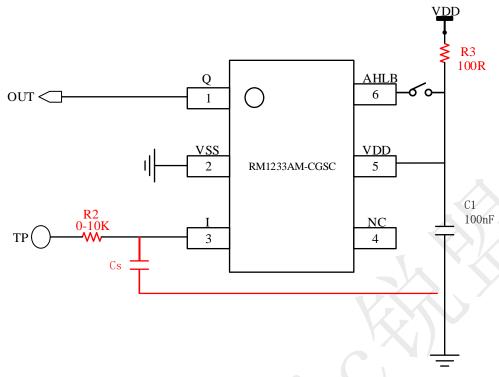


RM1233AM-KGSA/KGHA SOT23-6L 应用图

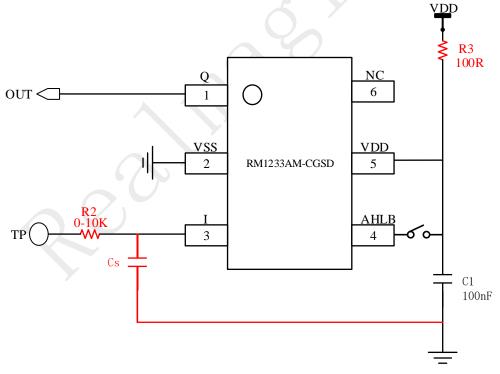


RM1233AM-CGSB/CGHB SOT23-6L 应用图



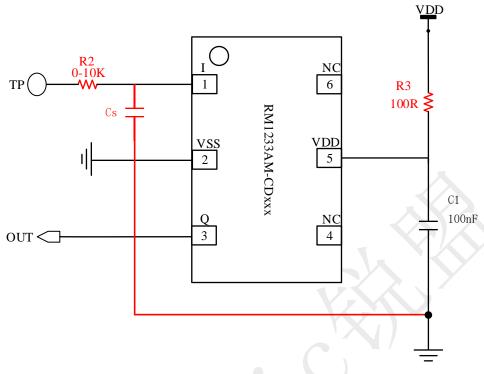


RM1233AM-CGSC SOT23-6L 应用图



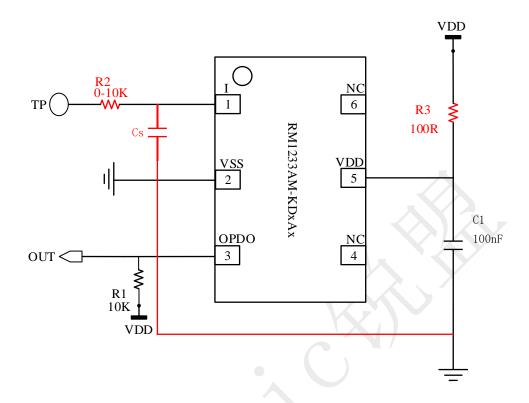
RM1233AM-CGSC SOT23-6L 应用图



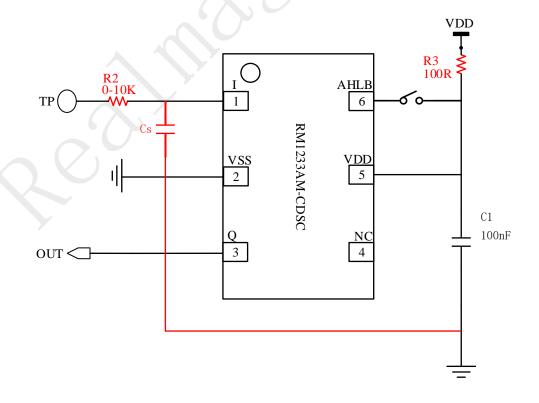


RM1233AM-CDxxx DFN-6L 应用图



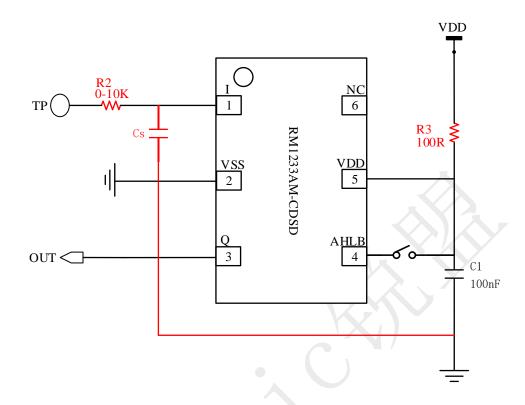


RM1233AM-KDxA DFN-6L 应用图

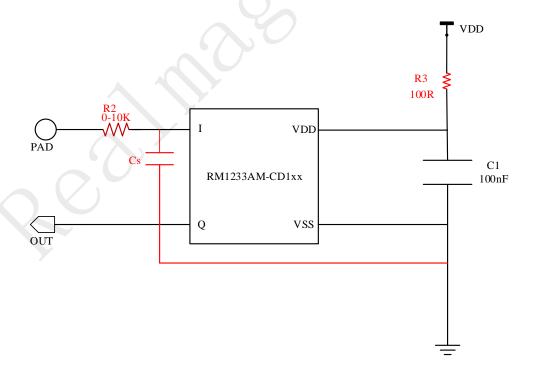


RM1233AM-CDSC DFN-6L 应用图



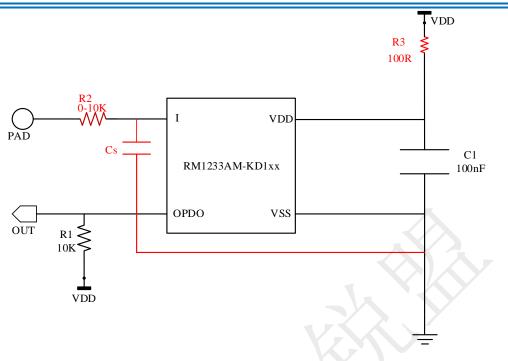


RM1233AM-CDSD DFN-6L 应用图



RM1233AM-CDxxx DFN1X1-4L 应用图





RM1233AM-KD1xx DFN1X1-4L 应用图



说明:

- 1.在PCB上,从触摸板到IC接脚的线长越短越好。且此接线与其它线不得平行或交叉。
- 2.电源供应必须稳定,若供应电源之电压发生飘移或快速漂移或移位,可能造成灵敏度 异常或误侦测。
 - 3.覆盖在PCB上的板材,不得含有金属或导电组件的成份,表面涂料亦同。
- 4.必须在VDD和VSS间使用C1电容;且应采取与装置IC的VDD和VSS接脚最短距离的布线。
- 5.电阻 R2 为抗干扰电阻,增加此电阻能增加触摸的稳定性,强烈建议 PCB 板上留出 R2 的焊盘,不需要 R2 时短接掉。
- 6.电容 Cs 为灵敏度调整电容, Cs 的电容值越小灵敏度越高, 灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来调整, Cs 电容值的范围为 0~20pF。

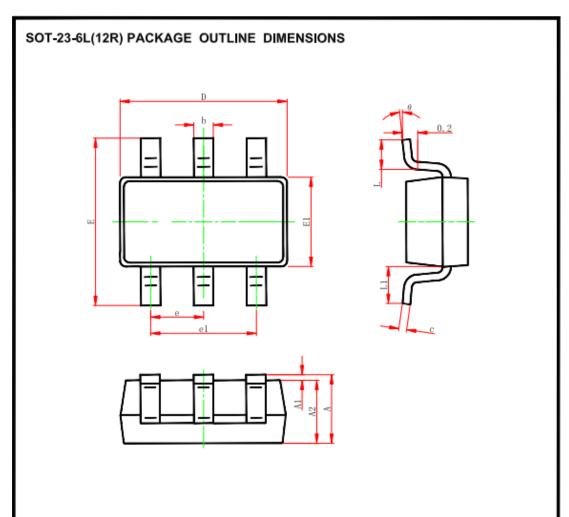
调整灵敏度的电容 Cs 必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器;如 X7R、NPO,故针对触摸应用,建议选择 NPO 电容器,以降低因温度变化而影响灵敏度。

- 7.VDD 使用 GPIO 供电: 放入充电仓时掉电,拿出充电仓时上电。
- 8. R3 100R电阻,可以改善整机ESD。
- 9.RM1233AM-KDxAx 上拉电阻R1,如果主控芯片内部可以配置上拉,可以省去。



7 封装信息

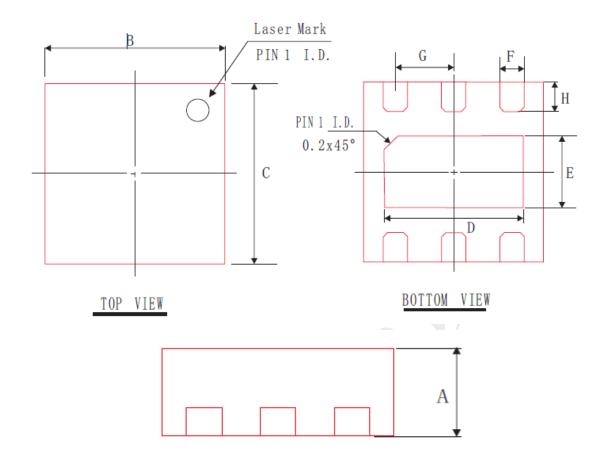
7.1 SOT23-6L 封装示意图



C	Dimensions In Millimeters		Dimensions	In Inches
Symbol	Min.	Max.	Min.	Max.
Α	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
С	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E1	1.500	1.700	0.059	0.067
E	2.650	2.950	0.104	0.116
е	0.950	(BSC)	0.037	(BSC)
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
Ĺ	0.300	0.600	0.012	0.024
L1	0.600REF.		0.02	4REF.
θ	0°	8°	0°	8°



7.2 DFN-6L 封装示意图



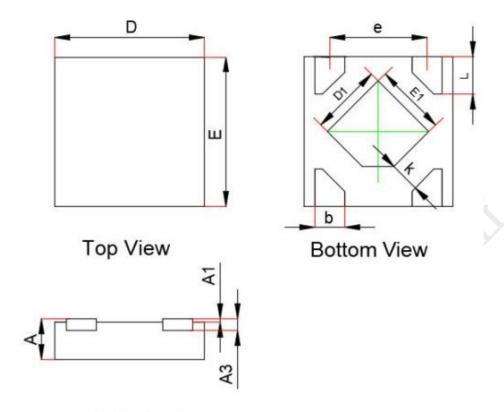
SIDE VIEW

COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=mm)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0. 70	0.75	0.80
В	1. 95	2.00	2.05
С	1. 95	2.00	2.05
D	1. 55	1.60	1.65
E	0.88	0.93	0.98
F	0. 25	0.30	0.35
G	0.625	0.65	0.675
Н	0. 31	0.36	0.41



7.3 DFN1X1-4L 封装示意图



Side View

Symbol	Dimesions In Millimeters				
Зуппрог	MIN	NOM	MAX		
Α	0.45	0.50	0.55		
A1	-	0.02	0.05		
А3	0.119	0.127	0.135		
D	0.95	1.00	1.10		
Е	0.95	1.00	1.10		
D1	0.43	0.48	0.53		
E1	0.43	0.48	0.53		
b	0.15	0.2	0.25		
K	0.2MIN				
Е	0.65BSC				
L	0.20	0.25	0.30		



8 修订记录

版本号	修订说明	日期
1.0	初版撰写	2022-06-10
1.3	增加型号、修改文字错误	2022-07-5
1.4	增加 RM1233AM-CDSC/CDSD 描述	2022-09-28
1.5	修改封装描述笔误	2022-11-01
1.6	更新 DFN4 1X1 封装外形描述	2022-12-10
1.7	更新灵敏度调节电容值	2023-02-15

拟制	审核	批准
n		



9 声明

本手册所述信息仅为您提供说明,该手册不保证没有进一步修改或更新,深圳锐盟半导体有限公司(以下简称本公司)保留随时对本手册及所述的产品和服务进行更改、修改或改进的权利,恕不另行通知。

本公司对所述信息不作任何形式的声明或担保,对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

除明确规定的定制产品外,包括本手册中描述的本公司的任何产品仅为普通商业、工业、个人和/或家庭应用而设计、开发和制造,禁止用于军事、国防、核能以及可能导致人身伤害、死亡,或是环境破坏等领域。用户应采取任何和所有行动,确保按照适用的法律法规使用和销售产品。

本公司对该手册拥有最终解释权。

如需索取更多信息,请联系我们:

地址:深圳市南山区高新北四道13号字阳大厦3层

3rd Floor, Eyang Building, No.13 Gaoxin North 4th Rd, Nanshan District, Shenzhen, 518057

网址: www.realmagicsemi.com

微信公众号: RealMagic-Semi



版权所有 © 深圳锐盟半导体有限公司

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得对本文档内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、



翻译、传播,或将其全部或部分用于商业用途。